



Title of Change:	Change in packing materials and packing quantity for LC823175PRA-4H	
Proposed first ship date:	30 November 2018 or earlier upon customer approval	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Toshinori.Takumi@onsemi.com>	
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Toshiya.Matsunami@onsemi.com>.	
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Change Part Identification:	Affected products will be identified with date code.	
Change Category:	<input type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input type="checkbox"/> Assembly Change <input type="checkbox"/> Test Change <input checked="" type="checkbox"/> Other <u>Packing materials</u>	
Change Sub-Category(s):	<input type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input checked="" type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input checked="" type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Tarlac City, Philippines	External Foundry/Subcon Sites: None
Description and Purpose:		
<p>This Final Notification announces the change of Packing materials. This material change enables stable and continuous product supply.</p> <p>Minimum Packing Quantity (MPQ) are changed from 1,300pcs to 2,080pcs as Appendix A.</p> <p>There is no impact to characteristic and Reliability Data</p> <p>See Attached: Appendix A _ Detailed documents of packing materials and quantity before and after change</p> <p><i>To view attachments:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Download pdf copy of the PCN to your computer 2. Open the downloaded pdf copy of the PCN 3. Click on the paper clip icon available on the menu provided in the left/bottom portion of the screen to reveal the Attachment field 4. Then click on the attached file/s 		
Electrical Characteristic Summary: Electrical characteristics are not impacted		
List of Affected Parts:		
Part Number		Qualification Vehicle
LC823175PRA-4H		LC823175PRA-H

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品/プロセス変更通知

文書番号: FPCN22415X

発行日: 23 August 2018

変更の件名:	LC823175PRA-4H の梱包材料および梱包数量の変更					
初回出荷予定日:	30 November 2018 (またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前)					
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または<Toshinori.Takumi@onsemi.com>にお問い合わせください。					
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または<PCN.samples@onsemi.com>にお問い合わせください。 サンプルは、今回の変更の初回通知、初回 PCN、または最終 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。					
その他の信頼性データ:	現地のオン・セミコンダクター営業所または<Toshiya.Matsunami@onsemi.com>にお問い合わせください。					
通知の種類:	これは、お客様宛の最終製品/プロセス変更通知 (FPCN) です。 FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせが行われない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com>にお願いします。					
変更部品の識別:	影響を受ける製品は日付コードで識別します。					
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input type="checkbox"/> 試験の変更 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <u>梱包材料</u>					
変更サブカテゴリ:	<input type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input checked="" type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input checked="" type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input checked="" type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他: _____					
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: タルラック市 (フィリピン)	外部ファウンドリまたは下請け業者拠点: なし				
説明および目的:	<p>本最終通知は梱包材料の変更を発表するものです。本材料変更は安定的かつ継続的製品供給を可能にするものです。</p> <p>最低梱包数量 (MPQ) は付録 A により 1,300 個から 2,080 個に変更されます。</p> <p>特性および信頼性データに影響はありません。</p> <p>添付を参照: 付録 A _ 梱包材料および数量の変更前後の詳細文書</p> <p>添付文書を見るには、</p> <ol style="list-style-type: none"> ご使用のコンピューターに PDF 版の PCN をダウンロードします。 ダウンロードした PDF 版の PCN を開きます。 画面の左側/下部にあるメニューでペーパークリップアイコンをクリックして、添付フィールドを表示します 添付ファイルをクリックします 					
電気特性の要約:	電気特性への影響はありません					
影響を受ける部品の一覧:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部品番号</th> <th>認証車両</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LC823175PRA-4H</td> <td>LC823175PRA-H</td> </tr> </tbody> </table>		部品番号	認証車両	LC823175PRA-4H	LC823175PRA-H
部品番号	認証車両					
LC823175PRA-4H	LC823175PRA-H					



Appendix A: Changed Products

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle
LC823175PRA-4H		LC823175PRA-4H